

臺灣矽品精密工業股份有限公司投資 12.74 億美元，在馬來西亞檳城州桂花城科技園區興建半導體廠房

資料蒐集：駐馬來西亞台北經濟文化辦事處經濟組

馬來西亞投資發展局 (MIDA) 、檳城投資機構 (InvestPenang) 與全球主要半導體封裝測試公司—臺灣矽品精密工業股份有限公司 (Siliconware Precision Industries Co., Ltd.，簡稱矽品公司) 頃聯合發布消息稱，矽品公司位於馬國檳城州桂花城科技園區(Bandar Cassia Technology Park)的工廠於本(5)月 24 日舉行動土禮，該廠投資額高達 60 億馬幣(約 12.74 億美元)。該廠占地 8 公頃預計將引進先進的封裝、測試技術與解決方案，包括晶圓凸塊、晶圓級晶片封裝、倒裝晶片封裝與測試。在未來 15 年內，上揭工廠預計將創造近 3,000 個技術就業機會，並縮短生產週期，提高半導體產業之效率與競爭力。

目前馬國在半導體組裝、測試與封裝領域佔據全球 13% 之市場占有率。北馬是部分全球最大半導體公司 (如英特爾與英飛凌科技公司) 以及主要電子產品製造商的總部所在地。

馬國矽品公司總執行長邁克張表示，該公司在檳城州的擴張將使馬國成為全球工業供應鏈之重要樞紐。此戰略將加強全球包裝與測試市場，推動集團內部之創新與發展，並促進東方矽谷的經濟增長。

另馬國投資、貿易暨工業部(MITI，簡稱投貿部)部長東姑賽夫魯(Tengku Zafrul)表示，前述投資證明馬國不僅是全球半導體公司的首選目的地，亦是一個迅速履行投資者承諾之國家。由投貿部領導之「國家半導體戰略特別工作小組」(NSSTF) 在馬國投資發展局逾 50 年專業知識之支持下，一直在推動許多吸引與落實該產業投資之關鍵措施。此類措施將有助馬國提升半導體產業在全球價值鏈中之地位。

馬國投資發展局執行長錫三蘇(Sikh Shamsul Ibrahim)強調稱，矽品公司的投資為馬國半導體產業創造巨大競爭優勢。作為全球十大外包半導體封裝與測試 (OSAT) 公司之一，在檳城州建設新工廠，彰顯馬國強大的半導體生態系。